

2024 九峰山论坛暨中国国际化物半导体产业博览会 (JFSC&CSE 2024)

详细日程

一、开幕大会:

开幕大会 / Opening Plenary	
时间: 2024 年 4 月 09 日 09:30-17:35	
Time: April 9, 2024 09:30-17:35	
地点: 中国武汉光谷科技会展中心 • 三层 • 大宴会厅	
Location: China Optics Valley Convention & Exhibition Center • 3 rd Floor • Grand Ballroom	
开幕式 / Opening Ceremony	
09:30-09:35	引言
09:35-09:45	嘉宾致辞
09:45-09:55	高新区推介
09:55-10:05	2023 第三代半导体产业发展报告发布
10:05-10:15	九峰山实验室 2024 重点服务能力发布
10:15-10:30	签约
大会主旨报告 / Plenary Speeches	
10:30-11:00	微系统, 大作为——智能微系统技术 Small Systems, Big Achievements——Intelligent Microsystem Technology 尤 政——中国工程院院士、华中科技大学校长 YOU Zheng — — Academician of Chinese Academy of Engineering, President of Huazhong University of Science and Technology
11:00-11:30	DFX: 基于数字孪生技术电力电子芯片和封装的设计与制造 DFX: Design and Manufacturing of Power Electronics Chips and Packaging Based on Digital Twin Technology 刘 胜——中国科学院院士、武汉大学教授 LIU Sheng — — Academician of Chinese Academy of Sciences, Professor of Wuhan University
11:30-12:00	用于材料集成的晶圆键合技术 Wafer Bonding Technology for Materials Integration Viorel DRAGOI——EV Group 首席键合科学家 Viorel DRAGOI——Chief Scientist Wafer Bonding of EV Group E. Thallner GmbH
12:00-14:00	午餐 / Lunch
大会主旨报告 / Plenary Speeches	
14:00-14:25	异质集成 III-V/Si 激光器和放大器的硅光平台 Silicon Photonics Platform with Heterogeneously Integrated III-V/Si Lasers and Amplifiers 荣海生——英特尔研究院资深首席科学家 RONG Haisheng — — Senior Principal Scientist of Silicon Photonics Research and Development, Intel Labs
14:25-14:50	碳化硅的机遇与挑战

	<p>Opportunities and Challenges of Silicon Carbide 刘焯杰——芯联集成电路制造股份有限公司执行副总裁 LIU Xuanjie——Executive Vice President of United Nova Technology Co.,Ltd.</p>
14:50-15:15	<p>新型电力系统对功率半导体的挑战 The Challenges of Power Electronics Technology in the Perspective of Future Development of New-type Power System 黄伯宁——华为数字能源技术有限公司首席科学家 HUANG Boning——Chief Scientist of Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd.</p>
15:15-15:40	<p>锗、砷化镓、磷化铟半导体材料现状及发展 The current status and development of germanium, gallium arsenide, and indium phosphide semiconductor materials. 惠 峰——云南锗业公司首席科学家 HUI Feng——Chief Scientist of Yunnan Germanium</p>
15:40-15:55	茶歇 / Coffee Break
15:55-16:20	<p>可靠性测试于汽车工业- 全球广泛适用的可靠性标准以及 AQG 324 对半导体资格认证的意义 Reliability in the automotive industry – A travel around worlds Reliability standards and what AQG 324 means for the semiconductor qualification Frank HEIDEMANN——National Instruments (NI) 全球副总裁, 技术负责人 Frank HEIDEMANN——Vice President and Technology Leader of National Instruments</p>
16:20-16:45	<p>大功率半导体技术进展与挑战 Progress and Challenge of High Power Semiconductor Technology 刘国友——株洲中车时代电气股份有限公司中车科学家 LIU Guoyou——CRRC Scientists of Zhuzhou CRRC Times Electric Co., LTD</p>
16:45-17:10	<p>化合物半导体的全球格局下, 中国光电子企业的机遇与探索 Opportunities and explorations for Chinese optoelectronic enterprises in the global landscape of compound semiconductors 熊文——华工科技产业股份有限公司党委委员、副总裁 XIONG Wen——Vice President of HGTECH Co.,Ltd.</p>
17:10-17:35	<p>全彩集成氮化物 Micro LED 显示技术的挑战与进展 Challenges and Progress of Full color Integrated Nitride MicroLED Display Technologies 闫春辉——九峰山实验室领域首席科学家 YAN Chunhui——Field Chief Scientist of JFS Laboratory</p>
19:00-21:00	欢迎晚宴 / Welcome Banquet

二、平行分论坛

平行论坛 1: 化合物半导体关键材料

Parallel Forum 1: Critical Materials of Compound Semiconductors

时间: 2024 年 4 月 10 日 09:00-18:00 & 11 日 09:00-12:00

Time: Time: April 10, 2024 09:00-18:00 & April 11, 2024 09:00-12:00

地点: 中国武汉光谷科技会展中心 • 三层 • 多功能厅 3

Location: China Optics Valley Convention & Exhibition Center • 3rd Floor • Multi-Function Hall 3

4月10日 / April 10

09:00-09:25 大尺寸碳化硅衬底材料技术及产业进展
Technology and Industrial Progress of Large Size Silicon Carbide Substrate Materials
刘春俊——北京天科合达半导体股份有限公司首席技术官
LIU Chunjun——CTO of TankeBlue Co., Ltd

09:25-09:50 国产光刻胶的关键技术及多元化产业链
Key Technologies and Diversified Industry Chain of Domestic Photoresist
李冰——北京科华微电子材料有限公司总经理
LI Bing——General Manager of Kempur Microelectronics Inc.

09:50-10:15 CMP 材料技术发展及产业化现状
Technology and industrialization status of CMP materials
王磊——湖北鼎汇微电子材料有限公司总经理
WANG Lei——General Manager of Dinghui Microelectronics

10:15-10:40 助力化合物半导体之下一代先进光刻技术
The Next Generation Advanced Lithography Technology Promoting the Development of Compound Semiconductors
向诗力——九峰山实验室光刻研发负责人
XIANG Shili——Head of Photolithography Research at JFS Lab

10:40-10:55 茶歇 / Coffee Break

10:55-11:20 宽禁带半导体单片集成和集成电路
Wide bandgap monolithic integration and ICs
李晓航——沙特阿卜杜拉国王科技大学副教授
LI Xiaohang——Associate Professor of King Abdullah University of Science & Technology

11:20-11:45 高纯半导体材料技术进展及应用展望
Progress and Application Prospects of High Purity Semiconductor Materials Technology
卢鹏荐——武汉拓材科技有限公司董事长兼总经理
LU Pengjian——Chairman & General Manager of Wuhan Tuocai Technology co.,Ltd

11:45-12:10 先进键合集成技术与应用
Advanced bonding integration technology and its applications
母凤文——北京青禾晶元半导体科技有限责任公司董事长
MU Fengwen——Chairman of Isabers Materials

12:10-13:30 午餐 / Lunch

主持人 **魏强民 / WEI Qiangmin**
Moderator 九峰山实验室宽禁带材料研究首席专家
Chief Expert of Wide-band Gap Material at JFS Lab
黎明锴 / LI Mingkai
湖北大学材料科学与工程学院教授
Professor of School of Materials Science and Engineering, Hubei University
张召富 / ZHANG Zhaofu

	<p>武汉大学教授 Professor of Wuhan University</p>
13:30-13:55	<p>国产光刻胶的关键技术及进展 Key Technologies and Progress of Domestic Photoresist 杜光宇——徐州博康信息化学品有限公司博康光刻胶事业部总经理 DU Guangyu——Photoresist BD General Manager of Xuzhou B&C Chemical Co.,Ltd</p>
13:55-14:20	<p>宽禁带半导体氧化镓晶体生长与缺陷研究 Growth and defect study of wide bandgap semiconductor gallium oxide crystals 陶绪堂——山东大学讲席教授 TAO Xutang——Endowed Chair Professor of Shandong University</p>
14:20-14:45	<p>超宽禁带氧化镓半导体功率器件及光电探测器研究进展 Research Progress in Ultra-Wide Bandgap Semiconductor Gallium Oxide-Based Power Devices and Photodetectors 龙世兵——中国科学技术大学微电子学院执行院长、教授 LONG Shibing——Professor & Executive Dean of School of Micro-electronics, University of Science and Technology of China</p>
14:45-15:10	<p>p 型 NiO 赋能 Ga2O3 双极型电导和雪崩能力 p-NiO empowers Ga2O3 bipolar conduction and avalanche capability 叶建东——南京大学电子科学与工程学院教授 YE Jiandong——Professor of School of Electronic Science and Engineering, Nanjing University</p>
15:10-15:35	<p>金刚石半导体衬底的发展 The Development of Diamond Semiconductor Substrates 王宏兴——西安交通大学教授 WANG Hongxing——Professor of Xi'an Jiaotong University</p>
15:35-16:00	<p>氧化镓 SBD 界面缺陷分析 Interface defects in gallium oxide SBD 魏强民——九峰山实验室宽禁带材料研究首席专家 WEI Qiangmin——Chief Expert of Wide-band Gap Material at JFS Lab</p>
16:00-16:15	茶歇 / Coffee Break
16:15-16:40	<p>宽禁带氧化物半导体 SnO₂ 的紫外光探测器与 p 型掺杂研究 Investigation of the UV Photodetector and P-type Doping for Wide Bandgap Oxide SnO₂ 黎明锴——湖北大学材料科学与工程学院教授 LI Mingkai —— Professor of School of Materials Science and Engineering, Hubei University</p>
16:40-17:05	<p>宽禁带半导体辐射探测器研究 Research on wide bandgap semiconductor radiation detectors 梁红伟——大连理工大学集成电路学院院长、教授 LIANG Hongwei——Professor & Dean of Integrated Circuits School, Dalian University of Technology</p>
17:05-17:30	<p>超宽禁带半导体氧化镓射频及功率器件</p>

Ultra wide bandgap semiconductor RF and power devices for Ga₂O₃

周 弘——西安电子科技大学微电子学院教授

ZHOU Hong——Professor of School of Microelectronics, Xidian University

17:30-17:55 宽禁带半导体界面工程及其电子器件应用

Interface Engineering of Wide Bandgap Semiconductors and Its Applications in Electronic Devices

张召富——武汉大学教授

ZHANG Zhaofu——Professor of Wuhan University

17:55-18:20 精细石墨——半导体材料制造之柱

Fine Graphite, a pillar for semiconductor material manufacture

吴厚政——赛迈科先进材料股份有限公司首席技术官

WU Houzheng——CTO of SIAMC Advanced Material Corporation

4 月 11 日 / April 11

09:00-09:25 化合物半导体异质集成热物性检测技术

Thermophysical Characterization Technology for Heterogeneously Integrated Compound Semiconductors

袁超——武汉大学研究员

YUAN Chao——Professor of Wuhan University

09:25-09:50 半导体材料中热电子动力学

Hot Carrier Dynamics in Semiconductor Materials

汪林望——北京龙讯旷腾科技有限公司创始人兼首席科学家

WANG Linwang——Founder & Chief Scientist of Longxun Quantum

09:50-10:15 研磨抛光工艺在第四代半导体材料的应用

Precision Lapping & Polishing process for WBG

刘思齐——北京艾姆希半导体科技有限公司总经理

LIU Siqu——General Manager of MCF

10:15-10:30 茶歇 / Coffee Break

10:30-10:55 光电器件及集成技术中蚀刻及剥离制程应用

Application of Etching and Stripping Processes in Optoelectronic Devices and Integrated Technologies

许朱男——苏州博洋化学股份有限公司研发总监

XU Zhunan——Research & Development Director of Boyang Chemical

10:55-11:20 SiC 衬底磨抛新材料，助力衬底厂降本增效

Providing grinding and polishing new materials for SiC crystals, empowering substrate manufacturers to reduce costs and increase efficiency

陈 斌——深圳中机新材料有限公司董事长

CHEN Bin——Chairman of Shenzhen ZhongJi MicroMaterial Co.,Ltd

11:20-11:45 纳米铈基稀土抛光材料及其在半导体抛光中的应用进展

Nano-ceria based polishing slurries and their application in semiconductor CMP

杨娟玉——有研稀土新材料股份有限公司稀土分离与化合物事业部总经理

YANG Juanyu——General Manager of Rare Earth Separation and Compounds Division, Grirem Advanced Materials CO., Ltd.

平行论坛 2：化合物半导体核心装备

Parallel Forum 2: Core Equipment of Compound Semiconductors

时间：2024 年 4 月 10 日 09:00-17:35 & 11 日 09:00-12:00

Time: April 10, 2024 09:00-18:00 & April 11, 2024 09:00-12:00

地点：中国武汉光谷科技会展中心·三层·多功能厅 2

Location: China Optics Valley Convention & Exhibition Center • 3rd Floor • Multi-Function Hall 2

4 月 10 日 / April 10

09:00-09:25	<p>刻蚀-沉积一体化赋能化合物半导体功率器件的大规模制造</p> <p>Integrated Etch & Deposition Solutions Enabling Compound Semiconductor Power Devices HVM</p> <p>郭春祥——江苏鲁汶仪器股份有限公司 8 英寸刻蚀工艺主管 GUO Chunxiang——8-Inch Etching Process Supervisor of LEUVEN Instruments Limited</p>
09:25-09:50	<p>黄光湿法制程设备在新型电子器件领域的创新应用</p> <p>Innovative applications of photography and wet-process equipment in the field of new electronic devices</p> <p>汪 钢——宁波润华全芯微电子设备有限公司创始人 WANG Gang——Founder of Ningbo All-Semi Micro Electronics Equipment Co., Ltd</p>
09:50-10:15	<p>需求引领，技术创新，构建中国碳化硅产业新生态</p> <p>Demand Leadership, Technological Innovation, Building a New Ecosystem for China's Silicon Carbide Industry</p> <p>李仕群——北京北方华创微电子装备有限公司行业总经理 LI Shiqun——Marketing General Manager of Beijing NAURA Microelectronics Equipment Co.,Ltd</p>
10:15-10:40	<p>化合物半导体异质集成晶圆键合技术与应用</p> <p>Wafer bonding technology and application in heterogeneous integration of compound semiconductors</p> <p>张洁琼——九峰山实验室键合工艺技术开发负责人 Zhang Jieqiong——Head of Bonding Technology Development at JFS Laboratory</p>
10:40-10:55	茶歇 / Coffee Break
10:55-11:20	<p>ULVAC 面向化合物半导体的解决方案</p> <p>ULVAC solutions for compound semiconductors</p> <p>左 超——爱发科商贸（上海）有限公司 营业本部本部长 ZUO Chao——General Manager of Sales Department, ULVAC (Shanghai) Trading Co., Ltd.</p>
11:20-11:45	<p>化合物半导体电子束量测技术的机遇和挑战</p> <p>Opportunities and Challenges of eBeam Metrology in Compound Semiconductor</p> <p>雒晓军——东方晶源微电子科技(北京)股份有限公司副总裁 LUO Xiaojun——Vice President of Dongfang Jingyuan Electron Co., Ltd.</p>
11:45-12:10	专用光学去噪声技术在 wafer AOI 的应用

	<p>The Application of Optical Noise Reduction Technology in wafer AOI</p> <p>龙凤彩——珠海诚锋电子科技有限公司产品总监 LONG Fengcai——Product Director of Zhuhai Chengfeng Electronic Technology Co., LTD.</p>
12:10-14:00	午餐 / Lunch
<p>主持人 Moderator</p>	<p>赵波 / ZHAO Bo 九峰山实验室工艺中心 TD 负责人 TD Manager of Process Center, JFS Laboratory</p> <p>陈怡骏 / CHEN Yijun SPTS Technologies Limited 技术经理 Technical Manager of SPTS Technologies Limited</p>
14:00-14:25	<p>打造三代半导体制造关键设备，原子层沉积和离子注入 Building key equipment for wide bandgap semiconductor manufacturing, atomic layer deposition and ion implantation</p> <p>陈祥龙——青岛四方思锐智能技术有限公司副总经理 CHEN Xianglong——Deputy General Manager of Sri Intellectual</p>
14:25-14:50	<p>应用于碳化硅等宽禁带材料的等离子体刻蚀和沉积工艺 Plasma Etch and Deposition Processes for SiC and other WBG Materials</p> <p>陈怡骏——SPTS Technologies Limited 技术经理 CHEN Yijun——Technical Manager of SPTS Technologies Limited</p>
14:50-15:15	<p>九峰山实验室设备国产化验证方案 Equipment Localization Verification Programme of JFS Lab</p> <p>赵波——九峰山实验室工艺中心 TD 负责人 ZHAO Bo——TD Manager of Process Center, JFS Laboratory</p>
15:15-15:40	<p>基于 MBE 的化合物外延和界面钝化开发介绍 Introduction to Development of Compound Epitaxy and Interface Passivation Based on MBE</p> <p>谢斌平——费勉仪器科技(上海)有限公司首席技术官 XIE Binping——CTO of Fermion instruments (Shanghai) Co., LTD.</p>
15:40-15:55	茶歇 / Coffee Break
15:55-16:20	<p>先进抛光技术助力 8 寸碳化硅量产 Advanced polishing technology helps mass production of 8-inch silicon carbide</p> <p>刘泳沅——北京特思迪半导体设备有限公司 创始人&CEO LIU Yongfeng——Founder & CEO of Beijing TSD Semiconductor Equipment Co., Ltd.</p>
16:20-16:45	<p>激光能为我们做什么——激光在化合物半导体产业中的应用 What can laser help - laser applications in the compound semiconductor industry</p> <p>王爽——苏州德龙激光股份有限公司行业经理 WANG Shuang——Marketing Manager of Suzhou Delphi Laser Co., Ltd.</p>
16:45-17:10	<p>超快激光材料加工技术的机遇与挑战 Opportunities and Challenges in Ultrafast Laser Material Processing Technology</p> <p>李赵青——武汉华日精密激光股份有限公司应用工艺部经理 LI Zhaoqing——Manager of the Application Process Department and the Director of Precision Micro-Nano Processing Research Laboratory at Wuhan Huari Precision Laser Co.,</p>

	Ltd
17:10-17:35	化合物半导体生产中的电镀工艺 Electroplating Process in Compound Semiconductor Production 印琼玲——新阳硅密（上海）半导体技术有限公司执行副董事长 YIN Qiongling——Executive Vice Chairwoman of Systech Technology Co., Limited
4月11日 / April 11	
09:00-09:25	激光微纳加工技术在碳化硅材料中的应用 Application of Laser Micro/Nano Processing Technology in Silicon Carbide Materials 黄 伟——华工激光精密事业群半导体面板事业部总监 HUANG Wei——BD Director of Semiconductor Panel at HGLaser Engineering Co., Ltd.
09:25-09:50	车规级功率半导体塑封技术及未来趋势 Automotive power semiconductor EMC molding technology and future trends 曹 萍——卓尔半导体设备(苏州)有限公司总经理 CAO Ping——General Manager of Zhuoer Semiconductor Equipment (Suzhou) Co., Ltd
09:50-10:15	高精度 MEMS 光纤传感器在半导体设备及机器人上的应用 Application of high-precision MEMS fiber optic sensors in semiconductor equipment and robots 郭凉杰——上海拜安半导体有限公司总经理 GUO Liangjie——General Manager of BAIANTEK Limited
10:15-10:30	茶歇 / Coffee Break
10:30-10:55	先进封装良率提升解决方案/机遇与挑战 Advanced Packaging Yield Improvement Solutions/Opportunities and Challenges 张景南——南京屹立芯创半导体科技有限公司总经理 ZHANG Jingnan——General Manager of Elead Technology Co., Ltd.
10:55-11:20	二元气体浓度仪在半导体行业的应用 The application of binary gas concentration meters in the semiconductor industry 江晓松——上海先普气体技术有限公司 董事长兼总经理 JIANG Xiaosong——Chairman & General Manager of Shanghai Xianpu Gas Technology Co., Ltd.
11:20-11:45	半导体芯片制造缺陷检测技术及设备 Defect inspection technology and equipment in Semiconductor chip manufacturing 徐景瑞——中导光电设备股份有限公司高级副总裁 XU Jingrui——Senior VP of Zhongdao Optoelectronic Equipment Co., Ltd.

平行论坛 3：EDA 工具与生态链

Parallel Forum 3: EDA Tools and Ecological Chain

时间：2024 年 4 月 11 日 09:00-12:15

Time: April 11, 2024 09:00-12:15

地点：中国武汉光谷科技会展中心·三层·大会议厅 1

Location: China Optics Valley Convention & Exhibition Center • 3rd Floor • Grand Conference Hall 1

09:00-09:20 **高性能、低成本、小型化的硅基集成无源器件技术**

	<p>High-performance, low-cost, miniaturized, silicon-based integrated passive device technology</p> <p>郭 涛——九峰山实验室研究中心工程师 GUO Tao——Engineer of Research Center at JFS Laboratory</p>
09:20-09:40	<p>RF SiP 混合集成架构的电磁仿真解决方案</p> <p>The solution of EM simulation for RF SiP Hybrid Integrated Architecture</p> <p>周海涛——湖北九同方微电子有限公司产品总监 ZHOU Haitao——Product Director of Nine Cube Co.,Ltd</p>
09:40-10:00	<p>化合物半导体智能制造-CIM</p> <p>Intelligent Manufacturing of Compound Semiconductors – CIM</p> <p>梁惠生——上扬软件(上海)有限公司技术总监 LIANG Huisheng——Technical Director of FA Software</p>
10:00-10:20	<p>器件特性分析与建模自动化</p> <p>Device characteristic analysis and modeling automation</p> <p>林 煊——北京华大九天科技股份有限公司技术总监 LIN Xuan——Technical Director of Empyrean Technology</p>
10:20-10:35	茶歇 / Coffee Break
10:35-10:55	<p>纳米尺度 MOSFET 仿真与设计工艺协同优化</p> <p>Nanoscale MOSFET Simulation and DTCO</p> <p>王兴晟——华中科技大学教授 WANG Xingsheng——Professor of Huazhong University of Science and Technology</p>
10:55-11:15	<p>射频氮化镓器件非线性建模</p> <p>Nonlinear modeling of GaN RF devices</p> <p>徐跃杭——电子科技大学教授 XU Yuehang——Professor of University of Electronic Science and Technology of China</p>
11:15-11:35	<p>光电集成芯片仿真与加速技术</p> <p>Photonics Integrated Circuit Simulation and Acceleration Technology</p> <p>赵 佳——上海曼光信息科技有限公司总经理 ZHAO Jia——General Manager of Shanghai Max-Optics Information Technology Co., Ltd.</p>
11:35-11:55	<p>芯片多物理场仿真软件研发</p> <p>Research and Development of Chip Multiphysics Simulation Software</p> <p>朱子玉——北京云道智造科技有限公司副总裁、CTO ZHU Ziyu——VP & CTO of Beijing Internet Based Engineering Co., Ltd</p>
11:55-12:15	<p>智能制造系统在晶圆生产中的应用及思考</p> <p>Application and Reflection of Intelligent Manufacturing Systems in Wafer Production</p> <p>杨旭东——上海乘黄智造软件科技有限公司董事长 YANG Xudong——Chairman of Chenghuang Intelligent Manufacturing System Co., Ltd.</p>

平行论坛 4: 光电子技术

Parallel Forum 4: Optoelectronic Technologies

时间: 2024 年 4 月 10 日 09:00-17:35 & 11 日 09:00-11:45

Time: April 10, 2024 09:00-17:35 & April 11, 2024 09:00-11:45

地点: 中国武汉光谷科技会展中心·三层·大会议厅 2-A

Location: China Optics Valley Convention & Exhibition Center · 3rd Floor · Grand Conference Hall 2-A

4月10日 / April 10

09:00-09:25	<p>面向未来大容量互连演进的光电子器件需求和挑战 Requirements and Challenges of Optoelectronic Devices for Future High-Capacity Interconnect Evolution</p> <p>满江伟——海思光电子有限公司先进光电实验室主任 MAN Jiangwei——Director of Hisilicon's Advanced Opto-Electronics Laboratory, Hisilicon OptoElectronics CO., LTD.</p>
09:25-09:50	<p>硅基高速调制探测器件及其集成工艺 Silicon based high-speed modulation detection device and its integration process</p> <p>蔡艳——中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员 CAI Yan——Professor of Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology, CAS</p>
09:50-10:15	<p>适用于人工智能驱动的分布式计算机架构的光子集成网络 Photonic integrated networking suitable for AI-driven disaggregated computer architecture</p> <p>陈晓刚——苏州海光芯创光电科技股份有限公司首席科学家 CHEN Xiaogang——Chief Scientist of CREALIGHTS Technology (Suzhou) CO., Ltd</p>
10:15-10:40	<p>硅基光子混合集成技术 Silicon Photonics Heterogeneous Integration Technology</p> <p>冯俊波——联合微电子中心有限责任公司 (CUMEC) 硅基光子中心主任 FENG Junbo —— Head of Silicon-Based Photonics Center at United Microelectronics Center (CUMEC)</p>
10:40-10:55	<p>茶歇 / Coffee Break</p>
10:55-11:20	<p>绝缘体上铌酸锂的集成光子学 Integrated photonics on lithium niobate on insulator</p> <p>Thach NGUYEN——皇家墨尔本理工大学副教授 Thach NGUYEN——Associate Professor at Royal Melbourne Institute of Technology, Australia</p>
11:20-11:45	<p>异质集成光子集成电路的设计自动化 Design Automation for Heterogeneously Integrated Photonic ICs</p> <p>Pieter DUMON——Luceda Photonics 首席技术官 Pieter DUMON——CTO of Luceda Photonics</p>
11:45-14:00	<p>午餐 / Lunch</p>
主持人 Moderator	<p>沈平 / SHEN Ping 南方科技大学教授 Southern University of Science and Technology</p> <p>余思远 / YU Siyuan 中山大学教授 Professor of Sun Yat-sen University</p>

14:00-14:25	芯间光互联的发展与挑战 The Development and Challenges of Inter Chiplet Optical Interconnection 阮祖亮——新华三技术有限公司研发工程师 RUAN Zuliang——R&D Engineer of New H3C Technologies Co., Ltd
14:25-14:50	硅光在 AI 计算中的应用 Applications of Silicon Photonics in AI Computing 杨 莉——苏州熹联光芯微电子科技有限公司 CEO 兼总经理 YANG Li——CEO & General Manager of DAWNSEMI
14:50-15:15	AIGC 加速高速光模块的应用与发展 AIGC Accelerates the Application and Development of High-Speed Optical Transceivers 张金双——成都新易盛通信技术股份有限公司业务拓展总监 ZHANG Jinshuang——BD Director of Eoptolink Technology Inc., Ltd.
15:15-15:40	硅光集成调频连续波激光雷达 Silicon Photonics Integrated FMCW Lidar 王 冠——北京摩尔芯光科技有限公司联合创始人 WANG Guan——Co-founder of Beijing Morelite Technologies
15:40-16:05	晶圆级光学的发展和應用 The Development and Application of Wafer Level Optics 林 涛——上海鲲游光电科技有限公司董事长 LIN Tao——Chairman of North Ocean Photonics
16:05-16:20	茶歇 / Coffee Break
16:20-16:45	氮化硅低损耗光集成芯片：从产品原型到规模量产 Low Loss Photonic Integrated Circuits from Prototype to Volume 姚灿——LIGENTEC 中国区市场销售总监 PIC 应用工程师 YAO Can——Marketing and Sales manager in China, LIGENTEC
16:45-17:10	先进光电子材料与集成技术 Advanced Photonic Integration Materials and Technologies 余思远——中山大学教授 YU Siyuan——Professor of Sun Yat-sen University
17:10-17:35	硅基电光调制技术的革新蓝图 Roadmapping the next generation of silicon photonics E-O modulators 张巍巍——英国南安普顿大学高级研究员 ZHANG Weiwei——Senior Researcher of University of Southampton
4 月 11 日 / April 11	
主持人 Moderator	李金钗 / LI Jinchai 厦门大学教授 Professor of Xiamen University 唐 江 / TANG Jiang 华中科技大学教授 湖北光谷实验室副主任、华中科技大学光学与电子信息学院院长 Professor of Huazhong University of Science and Technology
09:00-09:25	钙钛矿发光二极管研究

	Light emitting diodes based on halide perovskites 唐江——华中科技大学教授 湖北光谷实验室副主任、华中科技大学光学与电子信息学院院长 TANG Jiang——Professor of Huazhong University of Science and Technology
09:25-09:50	基于胶体半导体纳米结构研发激光器件 Developing Lasers from Colloidal Semiconductor Nanostructures 孙汉东——澳门大学教授 Sun Handong——Professor of University of Macau
09:50-10:15	基于微转印技术的晶圆级异质集成硅基光源与光模块 Si-based III-V DBR lasers and photonic integrated circuits through micro transfer printing heterogeneous integration 杨华——中国科学院半导体研究所研究员、光电子材料与器件重点实验室副主任 YANG Hua——Assistant Head of State Key Lab for Superlattices and Microstructures & Researcher of Institute of Semiconductors, CAS
10:15-10:30	茶歇 / Coffee Break
10:30-10:55	集成硅光子学与片上激光器 Integrated silicon photonics with on-chip lasers 万雅婷——沙特阿卜杜拉国王科技大学助理教授 WAN Yating——Assistant Professor of King Abdullah University of Science & Technology
10:55-11:20	显示用 MicroLED 技术新进展 New Progress in MicroLED Technology for Display 李金钊——厦门大学教授 LI Jinchai——Professor of Xiamen University
11:20-11:45	面向车载激光雷达的高可靠性 VCSEL 量产及未来趋势 High-reliability VCSELs for automotive LiDAR: mass production and future trends Ryan RAO——常州纵慧芯光半导体科技有限公司联合创始人& CTO Ryan RAO——Co-founder & CTO of VERTILITE

平行论坛 5：功率电子技术

Parallel Forum 5: Power Electronic Technologies

时间：2024 年 4 月 10 日 09:00-17:55

Time: April 10, 2024 09:00-17:55

地点：中国武汉光谷科技会展中心·三层·多功能厅 1

Location: China Optics Valley Convention & Exhibition Center •3rd Floor •Multi-Function Hall 1

09:00-09:25	低损耗碳化硅 MOSFET 器件的发展与挑战 Development and Challenges of Low Power Loss Silicon Carbide MOSFETs 邓小川——电子科技大学教授 DENG Xiaochuan——Professor of University of Electronic Science and Technology of China
09:25-09:50	碳化硅超结研究进展 Research Progress of Silicon Carbide Superjunction 王宽——九峰山实验室研发工程师

	WANG Kuan——Engineer of JFS Laboratory
09:50-10:15	<p>8 英寸蓝宝石基 GaN HEMTs 报道</p> <p>Report of GaN HEMTs on 8-inch Sapphire substrates</p> <p>李祥东——西安电子科技大学广州研究院副教授、广州第三代半导体创新中心副主任 LI Xiangdong——Associate Professor of Guangzhou Institute of Technology, Xidian University & Deputy Head of Guangzhou Wide Bandgap Semiconductor Innovation Center</p>
10:15-10:40	<p>面向更高电压应用的 GaN 功率器件与功率集成电路</p> <p>Towards higher-voltage GaN power devices and integrated circuits</p> <p>魏 进——北京大学集成电路学院研究员 WEI Jin——Researcher of School of Integrated Circuits, Peking University</p>
10:40-10:55	茶歇/Coffee Break
10:55-11:20	<p>功率氮化镓的痛点与展望</p> <p>Pain Points and Analysis in the Power GaN</p> <p>罗 鹏——成都氮矽科技有限公司 CEO LUO Peng——CEO of Chengdu danXi Technology Co.,Ltd.</p>
11:20-11:45	<p>高压大电流氧化镓功率电子器件最新进展</p> <p>The latest progress in high-voltage and high current gallium oxide power electronic devices</p> <p>吕元杰——中国电子科技集团公司第十三研究所重点实验室副主任、研究员 LV Yuanjie——Deputy Head & Researcher of State Key Lab at The 13th Research Institution of China Electronics Technology Group Corporation</p>
11:45-12:10	<p>硅终端金刚石场效应管器件研究</p> <p>Research on Silicon Terminated Diamond Field Effect Transistor Devices</p> <p>张金凤——西安电子科技大学教授 ZHANG Jinfeng——Professor of Xidian University</p>
12:10-13:30	午餐 / Lunch
主持人 Moderator	<p>张清纯 / ZHANG Qingchun 复旦大学上海碳化硅功率器件工程技术研究中心主任、清纯半导体董事长 Director of Center for Shanghai Silicon Carbide Power Devices Engineering & Technology Research, Fudan University; Chairman of SICHAIn</p> <p>张文渊 / ZHANG Wenyuan 北京昕感科技有限责任公司联合创始人 Co-founder of Beijing NEXIC Technology Co. Ltd.</p>
13:30-13:55	<p>车规级 SiC MOSFET 产业化进展</p> <p>Progress in commercialization of SiC MOSFETs for EV applications</p> <p>张清纯——复旦大学上海碳化硅功率器件工程技术研究中心主任、清纯半导体董事长 ZHANG Qingchun——Director of Center for Shanghai Silicon Carbide Power Devices Engineering & Technology Research, Fudan University; Chairman of SICHAIn</p>
13:55-14:20	<p>SiC 在功率器件的应用</p> <p>Application of SiC in Power Devices</p> <p>洪 涛——无锡芯动半导体科技有限公司首席技术官</p>

	HONG Tao——CTO of Wuxi XinDong Semiconductor Technology Co.,Ltd.
14:20-14:45	电动汽车主驱模块的开发与应用 Development & application of power modules in electrical vehicle traction inverter 余辰将——智新半导体有限公司研发部部长 YU Chenjiang_——Head of Research Department of ZhiXin Semiconductor
14:45-15:10	低导通电阻 SiC MOSFET 产品技术最新进展 The latest progress of low on-resistance SiC MOSFET product technology 张文渊——北京昕感科技有限责任公司联合创始人 ZHANG Wenyuan——Co-founder of Beijing NEXIC Technology Co. Ltd.
15:10-15:35	SiC 功率芯片制造中刻蚀技术的应用及工艺改善 Application and Process Improvement of Etching Technology in SiC Power Chip Manufacturing 王士京——上海邦芯半导体科技有限公司产品应用副总 WANG Shijing——Product Application VP of Shanghai Bangxin Semiconductor Technology Co. Ltd
15:35-15:50	茶歇/Coffee Break
15:50-16:15	先进半导体封装材料及未来趋势 Advanced Semiconductor Packaging Materials and Future Trends 陶 军——连云港华海诚科电子材料有限公司总经理 TAO Jun——General Manager of Lianyungang HHCK Electronic Materials Co. Ltd
16:15-16:40	大直径碳化硅外延技术与进展 Technical Progress of Large Diameter SiC epitaxy 张永强——河北普兴电子科技股份有限公司产品总监 ZHANG Yongqiang——Product Director of Hebei Poshing Electronics Technology Co.,Ltd
16:40-17:05	迈向更强更可靠的未来—赛默飞半导体功率器件研发及良率提升解决方案 Thermo Fisher Solutions for SiC Devices R&D and Yield Enhanced Geryk MICHAL——赛默飞世尔科技产品市场经理 Geryk MICHAL——Product Marketing Manager of ThermoFisher Scientific
17:05-17:30	宽禁带器件脉冲激光单粒子抗辐照效应研究进展 Research on wide-band gap semiconductors single event effects by pulsed laser 上官士鹏——中国科学院国家空间科学中心高级工程师、北京中科芯试验空间科技有限公司 总经理 SHANGGUAN Shipeng——Senior Engineer of National Space Science Center & General Manager of Beijing Zhongke Seeic Space Technology CO., Ltd
17:30-17:55	化合物半导体晶圆探针检测技术进展 Progress in compound semiconductor wafer probe detection technology 刘振辉——矽电半导体设备(深圳)股份有限公司技术总监 LIU Zhenhui——Technical Director of Sidea Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co.,Ltd

平行论坛 6: 无线电子技术

Parallel Forum 6: Wireless Electronic Technology

时间: 2024 年 4 月 10 日 09:00-18:00

Time: April 10, 2024 09:00-18:00

地点: 中国武汉光谷科技会展中心 • 三层 • 多功能厅 4

Location: China Optics Valley Convention & Exhibition Center • 3rd Floor • Multi-Function Hall 4

09:00-09:25	射频光子技术在无线通信的机会与挑战 Opportunities and challenges of Photonic Radio technology for wireless communication 王天祥——华为无线技术实验室高级专家 WANG Tianxiang——Senior Expert of Wireless Technology Labs
09:25-09:50	毫米波太赫兹集成电路及应用 Millimeter-Wave and THz ICs and Applications 洪 伟——东南大学毫米波全国重点实验室教授 HONG Wei——Professor of State Key Laboratory of Millimeter Waves, Southeast University
09:50-10:15	毫米波相控阵芯片设计进展 Development of millimeter wave phased array chip design 康 凯——电子科技大学电子科学与工程学院教授 KANG Kai——Professor of School of electronic Science and Engineering, University of Electronic Science and Technology of China
10:15-10:40	5G 下一代通信与智能网联汽车融合发展 The Integration and Development of 5G Next Generation Communication and Intelligent Connected Vehicles 任学锋——华砺智行科技有限公司副总裁 REN Xuefeng——Vice President of Huali iSmartWays Technology Inc.
10:40-10:55	茶歇 / Coffee Break
10:55-11:20	空间能量获取与物联网 Energy harvesting and IOT 黄卡玛——四川大学电子信息学院学术院长、无线能量传输教育部重点实验室主任 HUANG Kama——Dean of School of Electronic Information, Sichuan University & Head of State Key Lab of Wireless Energy Transmission, Ministry of Education
11:20-11:45	面向微波无线输能技术的氮化镓器件与模块 GaN devices and modules for microwave wireless power transmission technology 敖金平——江南大学教授 AO Jinping——Professor of Jiangnan University
11:45-12:10	电子级金刚石材料与射频器件的技术链协同 Synergy in the Technology Chain of Electronic-Grade Diamond Materials and RF Devices 赵立山——国防科技大学副研究员 ZHAO Lishan——Associate Professor of National University of Defense Technology
12:10-14:00	午餐 / Lunch

14:00-14:25	氮化物半导体射频材料与器件研究 Research on Nitride Semiconductor RF Materials and Devices 张进成——西安电子科技大学副校长、教授 ZHANG Jincheng——Vice President & Professor of Xidian University
14:25-14:50	应用于移动通信的 GaN 射频器件及技术 GaN RF Devices and Technologies Applied to Mobile Communications 李水明——海思技术专家 LI Shuiming——Technical Expert of Hisilicon Co.ltd
14:50-15:15	毫米波硅基氮化镓的机遇与挑战 Opportunities and challenges of millimeter wave silicon-based gallium nitride 吴 畅——九峰山实验室研究中心无线领域首席专家 WU Chang——Chief Expert of Wireless Field in JFS Laboratory
15:15-15:40	GaN 基 HEMT 和 MIS-HEMT 射频器件研究进展 Research progress on GaN-based RF HEMT and MIS-HEMT 黄森——中国科学院微电子研究所研究员 HUANG Sen——Professor of Institute of Microelectronics, Chinese Academy of Sciences
15:40-16:05	GaN 太赫兹二极管及大功率倍频器 GaN terahertz diodes and high-power multipliers 张 凯——中国电子科技集团第五十五所研究员 ZHANG Kai——Researcher of The 55 th Research Institute of China Electronics Technology Group Corporation
16:05-16:20	茶歇 / Coffee Break
16:20-16:45	可重构人工电磁超材料赋能的无线通信技术 Reconfigurable Electromagnetic Metamaterial-empowered Wireless Communication Technologies 尹海帆——华中科技大学教授 YIN Haifan——Professor of Huazhong University of Science and Technology
16:45-17:10	面向 6G 和 Wi-Fi 7 的高频与大带宽滤波器芯片 High Frequency and Wideband RF Filters for 6G and Wi-Fi 7 左成杰——中国科学技术大学教授 ZUO Chengjie——Professor of University of Science and Technology of China
17:10-17:35	高钪掺杂氮化铝材料及其 MEMS 应用研究与进展 Research and progress on high-concentration scandium-doped aluminum nitride materials and their MEMS applications 孙成亮——武汉大学二级教授、武汉敏声新技术有限公司董事长 SUN Chengliang——Professor of Wuhan University, Chairman of MEMSonics
17:35-18:00	先进封装在无线射频的应用 Application of Advanced Packaging in Wireless RF 于大全——厦门云天半导体科技有限公司董事长 YU Daquan——Chairman of Xiamen Sky Semiconductor Technology Co., Ltd.

平行论坛 7: 先进半导体检测技术与标准

Parallel Forum 7: Testing Technologies and Standards of Advanced Semiconductors

时间: 2024 年 4 月 10 日 13:30-18:15 & 11 日 08:30-12:05

Time: April 10, 2024 13:30-18:15 & April 11, 2024 08:30-12:05

地点: 中国武汉光谷科技会展中心 • 三层 • 大会议厅 2-B

Location: China Optics Valley Convention & Exhibition Center • 3rd Floor • Grand Conference Hall 2-B

4 月 10 日 / April 10

13:30-13:55	<p>IEC 宽禁带半导体国际标准现状及发展趋势 Current Status and Development Trends of IEC International Standards for Wide Bandgap Semiconductors</p> <p>崔 波——中国电子科技集团公司第十三研究所研究员、全国半导体器件标准化技术委员会秘书长 CUI Bo——Researcher of The 13th Research Institute of China Electronics Technology Group Corporation & Secretary-general of National Technical Committee 78 on Semiconductor Devices of Standardization Administration of China</p>
13:55-14:20	<p>SIMS 在化合物半导体表征上的应用 SIMS Characterization for Compound Semiconductor R&D and Manufacturing</p> <p>高玉民——九峰山实验室质谱检测中心首席科学家、微分科技有限公司总经理 GAO Yumin——Chief Scientist of Mass Spectrometry Testing Center at JFS Lab & General Manager of WF Technologies</p>
14:20-14:45	<p>宽禁带功率半导体动态可靠性测试的挑战--以及如何克服这些挑战 Challenges in dynamic reliability testing of WBG Power Semiconductors – and how to overcome them</p> <p>Frank HEIDEMANN——恩艾中国仪器有限公司(NI)副总裁 Frank HEIDEMANN——Vice President and Technology Leader of National Instruments</p>
14:45-15:10	<p>化合物半导体材料中痕量杂质检测方法介绍 Introduction to detection methods for trace impurities in compound semiconductor materials</p> <p>李春华——上海市计量测试技术研究院电子化学品计量检测技术服务平台主任 LI Chunhua—— E-chemicals SGS Chief of SIMT</p>
15:10-15:35	<p>针对新一代化合物半导体的失效分析解决方案 Failure Analysis solution for next generation compound semiconductor</p> <p>傅超——胜科纳米(苏州)股份有限公司副总经理 FU Chao——Deputy General Manager of Wintech Nano(Suzhou)Co.,Ltd.</p>
15:35-16:00	<p>(0001) InGaN/GaN 量子阱中绿光以外纳米应变弛豫与发光抑制研究 Luminescence quenching versus strain relaxation at the nanoscale in (0001) InGaN/GaN quantum wells for emission beyond the green range</p> <p>Pierre RUTERANA——法国国家科学研究中心 CNRS 主任研究员 Pierre RUTERANA——Chief Researcher of CNRS</p>
16:00-16:15	<p>茶歇 / Coffee Break</p>
16:15-16:40	<p>同步辐射 x 射线在半导体上的应用 The application of synchrotron x-rays on semiconductors</p> <p>坂田修身——日本高能同步辐射研究中心常务董事</p>

	Osami SAKATA—Executive Managing Director of Japan Synchrotron Radiation Research Institute
16:40-17:05	第三代化合物半导体材料表征技术 Characterization Techniques of Wide Band-gap Semiconductor Materials 麦志洪——九峰山实验室检测中心首席科学家 MAI Zhihong—Chief Scientist of Testing Center at JFS Laboratory
17:05-17:30	碳化硅晶圆缺陷检测设备国产化进程与挑战 The localization process and challenges of defect inspection equipment for silicon carbide wafers 李昊然——中电科风华信息装备股份有限公司半导体市场总监 LI Haoran—Semiconductor Marketing Director of CETC FENGHUA Information-Equipment CO.,Ltd
17:30-17:55	面向化合物半导体集成器件的国产化测试仪器研发进展 Research and Development Progress of Domestic Testing Instruments for Compound Semiconductor Integrated Devices 刘志明——中电科思仪科技股份有限公司光电仪器研发部主任 LIU Zhiming—Director of the R&D department of optoelectronic instruments, Ceyear Technologies Co., Ltd
17:55-18:20	SiC MOSFET 可靠性评估挑战与失效机理 Reliability evaluation challenges and failure mechanisms of SiC MOSFETs 陈媛——工业和信息化部电子第五研究所研究员 CHEN Yuan—Researcher of CEPREI
4月11日 / April 11	
08:30-08:55	GaN 功率器件标准测试验证及规划思考 Test Verification and Standard Planning of GaN Power Devices 贺致远——广东工业大学集成电路学院教授 HE Zhiyuan—Professor of School of Integrated Circuits, Guangdong University of Technology
08:55-09:20	高精测量与分析技术助力 MEMS 惯性器件从概念到量产 High precision measurement and analysis technologies assisting MEMS inertial devices from concept to mass production 刘彬——深迪半导体（绍兴）有限公司 MEMS 技术高级总监 LIU Bin—MEMS Senior Technical Director of Senodia Technologies (Shaoxing)Co., Ltd
09:20-09:45	表面分析于化合物半导体的应用 Applications of Surface Analysis to Compound Semiconductors 杨政霖——闵康技术检测（上海）有限公司表面分析部门主管 YANG Zhenglin—Supervisor of Surface Analysis Department , Materials Analysis Technology (Shanghai)Ltd.
09:45-10:10	APT 在半导体的应用（拟）三维原子探针在半导体中的应用 The application of three-dimensional atomic probes in semiconductors 黄亚敏——上海汽车芯片工程中心有限公司失效分析总监 HUANG Yamin—Invalid Analysis Director of SAICEC

10:10-10:35	“双碳”目标下 SiC 功率半导体模块测试挑战及应对 Testing Challenges and Solutions for SiC Power Semiconductor Modules under "Dual Carbon" Target 王 承——武汉普赛斯仪表有限公司副总经理 WANG Cheng——Deputy General Manager of WuHan Precise Instrument Co. , Ltd.
10:35-10:50	茶歇 / Coffee Break
10:50-11:15	SiC 功率半导体 JEDEC 新标解读与测量 SiC Power Semiconductor JEDEC New Standard Interpretation and Measurement 郭志勋——是德科技 (KEYSIGHT) 技术专家 GUO Zhixun——Technical Expert of KEYSIGHT
11:15-11:40	SCM 在半导体掺杂分析的应用 Application of SCM in Semiconductor Doping Analysis 冯 骅——掺流科技 (上海) 有限公司总经理 FENG Hua——General Manager of SHARP SCAN
11:40-12:05	宽禁带半导体 (GaN/SiC) 的量产测试挑战及解决方案 Mass Production testing challenges and solutions for wide bandgap semiconductors (GaN/SiC) 刘惠鹏——华峰测控市场部总监 LIU Huipeng —— Marketing Director of Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.,Ltd.

平行论坛 8：2024 化合物半导体产业发展投资论坛

Parallel Forum 8: Investment and Financing Trends in Compound Semiconductor

时间：2024 年 4 月 10 日 09:00-17:00

Time: April 10, 2024 09:00-17:00

地点：中国武汉光谷科技会展中心·三层·大会议厅 1

Location: China Optics Valley Convention & Exhibition Center • 3rd Floor • Grand Conference Hall 1

组织机构 Organization

指导单位：武汉东湖高新区管委会、长江产业投资集团有限公司

主办单位：第三代半导体产业技术创新战略联盟、湖北九峰山实验室、湖北科技创新投资有限公司

承办单位：湖北省创业投资同业公会、深交所湖北资本市场培育基地、长江创业投资基金管理有限公司、长江产业投资私募基金管理有限公司

时间	内容
4 月 10 日 上午	
09:00-09:30	参会签到
09:30-09:35	主持人开场
09:35-09:40	开幕致辞 长江产业投资集团主要领导
09:40-09:45	开幕致辞 东湖高新区领导
09:45-10:55	基金及项目签约

	第一批：半导体相关基金签约 第二批：半导体相关项目签约
09:55-10:25	主题分享：半导体产业现状及发展趋势 中信证券电子行业首席分析师 徐涛
10:25-10:50	主题分享：投资视角下的功率半导体市场竞争及产业机会 中芯聚源合伙人 赵森
10:50-11:15	主题分享：碳化硅产业发展机遇和挑战 三安光电 SiC 应用专家 许亚坡
11:15-12:00	圆桌论坛：不忘初“芯”、拥抱未来 【圆桌主持】 长江创投董事长 聂松涛 【论坛嘉宾】 中国科学院创投投资一部总经理 韩一 深创投湖北负责人 刘巍 瑞江投资董事长 赵进强 韦豪创芯合伙人 王智 华引芯创始人 孙雷蒙
12:00-13:30	自助餐叙
4月10日下午	
14:00-14:30	参会签到
14:30-14:50	主题分享：化合物半导体技术灯塔引领产业生态聚集 分享嘉宾：九峰山实验室孵化平台相关负责人
14:50-17:00	项目路演： 1.武汉驿天诺科技有限公司 2.武汉芯导传能科技有限公司 3.中科光智（重庆）科技有限公司 4.武汉天工芯测科技有限公司 5.武汉优炜芯科技有限公司

三、同期活动

CSE 2024 行业分析报告会 CSE 2024 Industry Analysis Report Meeting	
时间：2024年4月9日 10:40-15:40 Time: April 9, 10:40-15:40 地点：中国武汉光谷科技会展中心·一层展区 Location: China Optics Valley Convention & Exhibition Center • 1st Floor Exhibition Area	
10:40-11:20	聚焦人工智能的光通信市场 Optical Communications Market with a Focus on AI Tom WILLIAM——LightCounting 高级分析师 Tom WILLIAM——Senior Analyst of LightCounting Market Research
11:30-12:10	半导体厂建要点和趋势 Key points and trends in semiconductor factory construction

	<p>卢标林——信息产业电子第十一设计研究院武汉分院副院长 LU Biaolin—— Vice President of Wuhan Institute, the IT Electronics Eleventh Design&Research Institute Scientific and Technological Engineering Corporation Limited (EDRI)</p>
14:30-15:00	<p>华为半导体工厂解决方案 Huawei Semiconductor Factory Solutions 艾小平——华为技术有限公司中国地区部半导体电子架构师 AI Xiaoping——Semiconductor Electronics Architect for China Regional Department, Huawei Technologies Co., Ltd.</p>
15:10-15:40	<p>安全可靠, 绿色低碳-华为助力半导体产线坚定运行 Safe and Reliable, Green and Low Carbon - Huawei Helps Semiconductor Production Lines Run Firmly 韩本杰——华为数字能源技术有限公司中国区精密制造关键供电拓展部部长 HAN Benjie——Director of Power Supply Expansion Department for Precision Manufacturing in China, Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd.</p>

是德科技化合物半导体培训会

Keysight Training Session on Compound Semiconductor

时间: 2024 年 4 月 8 日 13:30-17:30

Time: April 8, 2024 13:30-17:30

地点: 中国武汉光谷科技会展中心 • 三层 • 多功能厅 3

Location: China Optics Valley Convention & Exhibition Center • 3rd Floor • 3F Multifunctional Hall 3

13:30-14:00	签到 Sign In
14:00-15:00	<p>化合物半导体器件建模主流方案 Compound Semiconductor Devices Modeling Solutions in the Industry 主讲人: 高文明——是德科技器件模型应用工程师 Speaker: Wenming GAO——Application engineer for device modeling</p>
15:00-16:30	<p>采用化合物半导体工艺进行电路与模组设计的主要流程 Circuit and module design flow exploration using compound semiconductor process 主讲人: 许玥——是德科技射频微波软件应用工程师 王晓霞——是德科技 Foundry 及射频前端行业客户成功经理 Speaker: Xu Yue——Application engineer for RFMW designs Amanda Wang——Customer Success Manager for Foundry and RF front-end industry</p>
16:30-17:30	互动环节 / Interactive session

LUCEDA 光电子芯片设计技术研讨会暨 2024 全球用户大会

Photonics Integrated Circuits Design Symposium and 2024 Luceda User Group Meeting

时间: 2024 年 4 月 8 日 14:00-18:00

Time: April 8, 2024 14:00-18:00

地点：中国武汉光谷科技会展中心·三层·大会议厅 2

Location: China Optics Valley Convention & Exhibition Center •3rd Floor • Grand Conference Hall 2

13:30

签到 Sign in

14:00-14:15

致辞 Welcome

Erwin DE BAETSELIER (Luceda Photonics)

第一节：技术研讨会-专家报告

Session 1: Keynote Speech

14:15-14:30

Upcoming Challenges to PIC Design and Verification

余思远——中山大学教授

14:30-14:45

Silicon Photonics Integration Technology and Development Trends

冯俊波——联合微电子中心有限责任公司硅基光子中心主任

14:45-15:00

Photonic IC design: Innovation and Scalability

Pieter DUMON——Luceda 联合创始人兼首席技术官

第二节：技术研讨会-工艺进展

Session 2: Foundries

15:00-15:10

Low Loss Photonic Integrated Circuits from Prototype to Volume

Henry Francis——LIGENTEC MPW 负责人

15:10-15:20

Introduction to the Silicon Photonics Platform of Shanghai Industrial Technology Research Institute

蔡艳——中科院上海微系统与信息技术研究所研究员

15:20-15:30

Recent Progress and Development in Advanced Technology at CUMEC

Adam LEWIS——联合微电子中心市场开拓主管

15:30-15:40

PDK and Services for Silicon Photonics Technology Platform of Institute of Microelectronics of the Chinese Academy of Sciences

黄凯——中国科学院微电子研究所工程师

15:40-15:50

茶歇 / Coffee Break

第三节：技术研讨会-用户分享

Session 3: User Stories

15:50-16:00

Synthetic Frequency Dimension Lattices on A LNOI Integrated Photonic Platform

Thach NGUYEN——皇家墨尔本理工大学副教授

16:00-16:10

超低损耗氮化硅集成光子：从高非线性到掺铒光增益

Ultralow-loss Silicon Nitride Integrated Photonics: From High Nonlinearity to Erbium-enabled Optical Gain

纪歆茹——瑞士洛桑理工学院博士研究生

16:10-16:20

互动环节 / Activity - Fun Quiz

16:20-16:30

布里渊集成微波光子学

Brillouin-enabled Integrated Microwave Photonics

刘阳——悉尼大学博士后

16:30-16:40

光计算的方向、机遇和挑战

Direction, Opportunities, and Challenges of Photonic Computing

魏源——中科天鹰 光芯片研发部总监

16:40-16:50

基于混合架构光子计算芯片的高效强化学习

	High-efficiency Reinforcement Learning with Hybrid Architecture Photonic Integrated Circuit 李轩坤——上海交通大学博士研究生
16:50-17:00	互动环节 / Activity - Fun Quiz
17:00-17:10	面向信息通信产业的硅光技术创新平台 Silicon Optical Technology Innovation Platform for the Information and Communication Industry 常思垚——国家光电子创新中心 PIC PDK 经理
17:10-17:20	SiN Photonics for Healthcare Sarp KERMAN——近观科技芯片副总裁 Sarp KERMAN——Vice President of Chip, Photonic View
17:20-17:30	从光学平台走向片上世界 From Optical Platforms to On-Chip Realms 邢思哲——复旦大学博士研究生
17:30-17:40	互动环节 / Activity - Fun Quiz
第四节：LUCEDA 周年纪念仪式 Session 4: LUCEDA Anniversary Ceremony	
17:40-18:00	A Brief History of Luceda and Anniversary Celebration Wim BOGAERTS, Erwin DE BAETSELIER and Ruping CAO (Luceda Photonics)
18:00	闭幕致辞 / Closing remarks
18:30	LUCED 晚宴 / Dinner

充电头网-2024 世界碳化硅大会

时间：2024 年 4 月 10 日 10:00-16:00

Time: April 10, 2024 10:00-16:00

地点：中国武汉光谷科技会展中心·一层展区

Location: China Optics Valley Convention & Exhibition Center • 1st Floor Exhibition Area

10:00-10:20	半导体用 SiC/TaC 涂层部件的研究进展 邓军旺——湖南兴晟新材料科技有限公司总经理
10:20-10:40	碳化硅功率器件优势和 AOS aSiC 技术展望 朱礼斯——AOS 万国应用工程经理
10:40-11:00	主题待定 李 宾——纳微半导体应用总监
11:00-11:20	超快激光助力碳化硅产业升级 周 维——武汉华日精密激光股份有限公司行业总监
11:20-12:00	圆桌论坛
12:00-14:00	午休
14:00-14:20	SiC 助力新质生产力，森国科助力第三代半导体 杨承晋——深圳市森国科科技股份有限公司董事长
14:20-14:40	狂飙已四年-国产碳化硅产业发展的冷与热 高远——泰科天润半导体科技（北京）有限公司应用测试中心总监

14:40-15:00	主题待定 SGS 通标标准技术服务有限公司
15:00-15:20	第三代半导体和功率模块用 EMC 解决方案 刘 建——衡所华威电子有限公司副总工程师
15:20-15:40	碳化硅衬底及外延材料量测检测的挑战和国产替代进展 唐德明——上海优睿谱半导体设备有限公司总经理
15:40-16:00	圆桌论坛

ICC 讯石首届传感创新发展论坛

时间：2024 年 4 月 11 日 09:30-15:00

Time: April 11, 2024 09:30-15:00

地点：中国武汉光谷科技会展中心·一层展区

Location: China Optics Valley Convention & Exhibition Center • 1st Floor Exhibition Area

主办单位：ICC 讯石光通讯网、深圳市讯石科技有限公司、北京麦肯桥新材料生产力促进中心有限公司

时 间	内 容
09:30-09:55	散射增强光纤传感技术 孙琪真——华中科技大学 教授
09:55-10:20	特种光纤在光传感领域的新发展、新应用 杨晨——长飞 特种光纤首席科学家
10:20-10:45	海洋用光纤声呐传感技术及解决方案 周开军——光扬光电 总经理
10:45-11:10	国产测绘级激光雷达关键技术及应用 毛庆洲——武汉大学 教授
11:10-11:35	多芯光纤开发技术及其在传感领域的应用 廉正刚——长盈通 技术总监
12:00-13:00	午餐 / 观展
13:30-14:00	OFDR 技术在光纤链路中高精度定位的应用 柴红芳——圣德科 市场总监
14:00-14:30	主题待定 光迅科技
14:30-15:00	高速信号检测与 BOTDR 技术结合的应用 陈韬——德力光电 总经理

备注：上述日程安排仅供参考，最终以实际为准！